

# SR-LA

Der neue Allrounder  
The new "all-rounder"



Einsatz für alle Fälle – mit dem **SR-LA** von Almit haben Sie einen echten Universal-Lotdraht mit halogenaktiviertem Flussmittel für die verschiedensten Anwendungen zur Verfügung. Entwickelt speziell für niedrig-silberhaltige Legierungen, zeigt der SR-LA hervorragende Benetzungseigenschaften und besonders wenig Flussmittelspritzer. Ein weiterer Vorteil: Der SR-LA ist auch zum Einsatz bei sehr niedrigen Löttemperaturen bestens geeignet.

- ▶ vielseitig einsetzbar
- ▶ hervorragende Benetzungseigenschaften
- ▶ sehr wenig Flussmittelspritzer
- ▶ auch für niedrige Temperaturen geeignet
- ▶ RoHS-konform

*Suitable for every use – with the SR-LA from Almit you have a genuine all-purpose solder wire with a halogen-activated flux for the most widely varied applications at your disposal. Developed specially for alloys with a low silver content, the SR-LA has excellent wetting properties and a particularly low quantity of flux splashes. A further advantage: SR-LA is also ideally suitable for use at very low soldering temperatures.*

- ▶ use in a wide range of applications
- ▶ excellent wetting properties
- ▶ very low quantity of flux splashes
- ▶ also suitable for use at low soldering temperatures
- ▶ RoHS compliant

## SR-LA im Vergleichstest / in comparative test

Wir haben den SR-LA mit herkömmlichen Wettbewerbsprodukten verglichen. Das Ergebnis ist eindeutig: Sowohl bei Benetzungseigenschaften als auch bei Flussmittelspritzern ist der SR-LA deutlich überlegen. Folgende Tests haben wir durchgeführt:

*We have compared the SR-LA with the conventional competitors' products. The results are unambiguous: Both for its wetting properties and the amount of flux splashes the SR-LA is clearly superior. We carried out the following tests:*

### SR-LA Vergleich / comparison

Flussmittel / Flux	SR-LA	Referenztype / Existing Solder
Flussmittelaktivierung / Flux type	RO M1	RO M1
Legierung / Alloy	LFM-86	LFM-86
Zusammensetzung / Metal composition	Sn-0.3Ag-0.7Cu	Sn-0.3Ag-0.7Cu
Flussmittelanteil / Flux content	3.5%	3.5%

### Vergleich der Benetzungseigenschaften Solderability Comparison

Getestet wurden die Fließeigenschaften und die Benetzungsgeschwindigkeit von SR-LA im Vergleich zu einem Referenztyp, jeweils mit der LFM-86 Legierung. Am Beispiel eines THT-Bauteils. Gelötet mit einem Lötroboter.

*The fluid properties and wetting rate of SR-LA were tested in comparison to a reference sample of existing solder in each case with the LFM-86 alloy. Using the example of a THT component. Soldered with a soldering robot.*

#### Ausgangszustand Initial condition



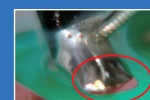
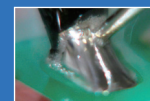
1.0 Sek. / sec



1.5 Sek. / sec



2.0 Sek. / sec



Das Ergebnis:  
Im Vergleich mit der Referenztype überzeugt SR-LA durch deutlich bessere Benetzungseigenschaften.

*The result: in comparison to the existing solder the SR-LA is convincing with its clearly better solderability properties.*

#### Bedingungen: Conditions:

320° C  
Löttemperatur  
Tip temperature

23 mm  
Drahtvorschub  
Feeding amount

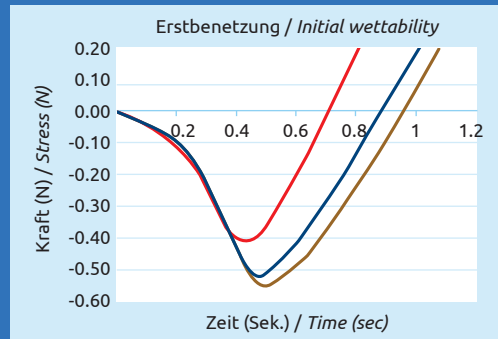
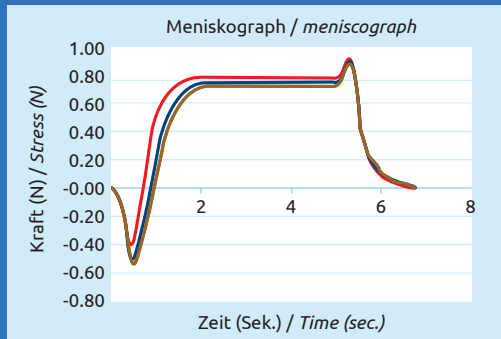
10 mm/s  
Vorschubgeschwindigkeit  
Feeding speed

5x3 mm  
Lötstellengröße  
Cu pad size

### Vergleich der Benetzungsgeschwindigkeit / Wetting rate comparison

Die Benetzungsgeschwindigkeit wurde unter der Verwendung eines Meniskographen verglichen.

The wetting speed was compared using a meniscograph.



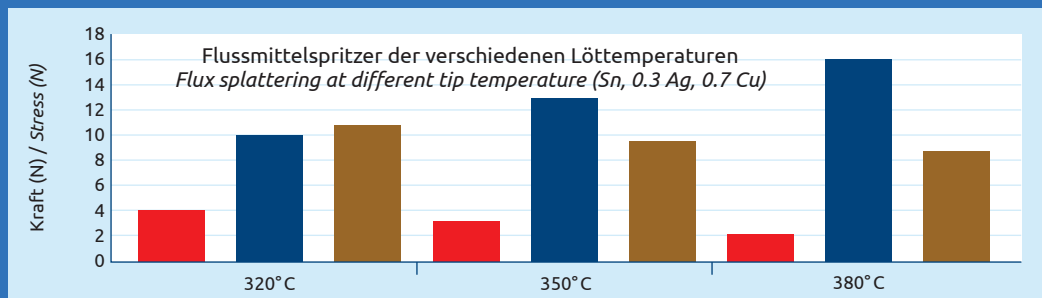
**Bedingungen / Conditions:**  
 320°C  
 Löttemperatur / Tip temperature  
 5 Sek. / sec  
 Eintauchzeit / Dipping time  
 2 mm  
 Eintauchtiefe / Dipping depth  
 Kupferplatte / Cu plate  
 Material / Materials

■ SR-LA ■ Referenztyp / Existing solder ■ Wettbewerbsprodukt / Competitive solder

### Vergleich Flussmittelspritzer / Flux splattering comparison

Auf einer Kupferplatte auf Thermopapier wurden Punkt-lötungen mit einem Lötroboter ausgeführt. Die Flussmittelspritzer auf dem Thermopapier wurden gezählt.

Spot solders were carried out on a copper plate on thermopaper using a soldering robot. The flux splashes on the thermopaper were counted.



**Bedingungen / Conditions:**  
 320°C 350°C 380°C  
 Löttemperatur / Tip temperature  
 5 mm  
 Drahtvorschub / Feeding amount  
 2 mm  
 Eintauchtiefe / Dipping depth  
 10 mm/s  
 Vorschubgeschwindigkeit  
 Feeding speed

Das Ergebnis: SR-LA hat bei jeder der getesteten Löttemperaturen deutlich weniger Flussmittelspritzer.  
 The result: At each soldering temperature tested SR-LA had significantly fewer flux splashes.

### Der perfekte Schutz vor Lotspitzen-Erosion: Almit M- und S-Linie The perfect protection against tip erosion: The Almit M- and S-Line

Die Almit M- und S-Linien sind speziell entwickelte mikrolegierte Lotlegierungen, die die Lötspitzenstandzeit drastisch erhöhen und der Lötspitzenoxidation vorbeugen. Sprechen Sie mit Ihrem Almit-Fachberater. Er zeigt Ihnen, wie Sie mit den Almit M- und S-Linien Ihre Kosten erheblich reduzieren können.

The Almit M and S lines are specially developed microalloyed alloys which drastically increase the working life of the soldering tip and prevent against oxidation of the soldering tip. Speak to your specialist Almit adviser. He will show you how you can considerably reduce your costs with the Almit M and S lines.

#### SR-LA Spezifikation / Specification

#### Universal-Lotdrähte im Überblick / all-purpose solder wires at a glance

Legierung / Alloy	Zusammensetzung / Composition	Schmelzbereich / Melting point	Flussmittelanteil / Flux content
SJM-03-S	Sn-0.3Ag-0.7Cu-2.0Bi	210 – 226°C	3.5%
LFM-48-M	Sn-3.0Ag-0.5Cu-α	217 – 221°C	3.5%
LFM-86-S	Sn-0.3Ag-0.7Cu-α	217 – 228°C	3.5%
SJM-40	Sn94-4.0Ag-2.0 Bi-0.02 Fe	217 – 223°C	3.5%

Almit-Drähte sind mit folgendem Durchmesser verfügbar / Almit solder wires available with following core diameters:  
 0.2, 0.3, 0.38, 0.5, 0.65, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.7

Für mehr Informationen sprechen Sie bitte mit Ihrem Almit-Fachberater. / For more information please speak to your specialist Almit adviser.